



产品特点

- 高导热率低界面热阻及良好触变性
- 无应力, 可无限压缩至至最薄0.1mm
- 无沉降、不流淌, 可填充任何高低不平间隙
- 设计应用方便, 配合自动点胶机可调节任意厚度尺寸
- 满足ROHS、REACH、UL等指令要求

典型应用

- CPU\GPU、晶闸管、晶片与散热片之间散热
- 汽车电子控制、驱动模块元器件与外壳之间的传热
- 网络设备、便携式电子装置、高端医疗器械等
- 新能源汽车电池、储能设备、热管散热模块等需热传导区域

使用说明

1. 清洁表面, 将需要涂覆的表面清洁整理干净, 除去锈迹、灰尘和油污等。
2. 通过自动点胶机或者手动挤压 (推荐使用点胶机) 等方法将导热凝胶涂覆于处理过的固体接触面。
3. 涂覆完成后, 再将第二表面 (如: 散热器或机壳) 与涂过导热凝胶的表面略施压紧即可。(注意: 导热凝胶不是涂得越多越好, 而是在保证填满间隙的情况下越薄越好。)
4. 操作完成后, 未用完的胶应立即拧紧盖帽, 密封保存。

技术参数

测试项目	单位	数值	测试标准
颜色	-----	深灰色 (GY)	Visual
挤出速度 (70psi 60S)	g/min	≥10	-----
比重	g/cc	3.5±0.15	ASTM D792
导热系数	w/m.k	8.0±0.2	ASTM D5470
最小结合厚度	mm	0.1	-----
介电常数	1MHz	2.5~3.0	ASTM D150
击穿电压	AC/0.1mm	>150V	GB/T1408.1-2006
体积电阻率	Ω.cm	>10 ¹³	GB/T1410-2006
耐温范围	°C	-50~150°C	EN344
防火性能	-----	V0	UL 94
存放时间	month	6	-----

注 1: 参考标准未注日期, 其最新版本适用于本文件

注意事项

1. 若不慎接触皮肤, 擦拭干净, 然后用清水冲洗; 若不慎接触眼睛, 立即用清水冲洗并到医院检查
2. 安全性资料请参阅产品的 MSDS

贮存要求

1. 本产品为无毒非危险品, 按一般化学品搬运和运输即可
2. 使用后注意密封, 储存于阴凉、干燥、通风处
3. 本产品密封储存保质期为6个月

包装规格

针筒包装: 30CC/支, 50CC/支, 300CC/支

桶罐包装: 1KG/桶, 5KG/桶, 10KG/桶, 20KG/桶

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得, 由于使用环境的差异, 使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。跨越电子不承担销售产品和特定工况下使用跨越电子产品出现的问题, 不承担任何直接, 间接或意外损失责任。用户在使用过程遇到什么问题, 可以和跨越电子技术服务部门联系, 我们将为您提供一切帮助。